EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05165015

PUBLICATION DATE

29-06-93

APPLICATION DATE

12-12-91

APPLICATION NUMBER

03328843

APPLICANT:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>;

INVENTOR:

IRITA YUKIO;

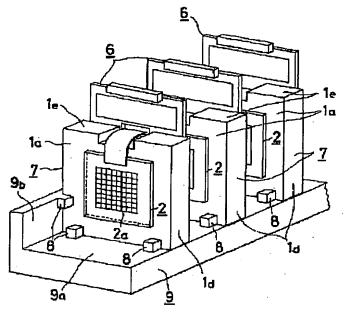
INT.CL.

G02F 1/1333 G02F 1/13 G02F 1/1347

TITLE

MOUNTING METHOD FOR OPTICAL

MODULE



ABSTRACT:

PURPOSE: To easily conduct optical axis alignment of many light switch modules without

troublesome adjustment.

CONSTITUTION: First, a liquid crystal light switch matrix substrate 2 is fixed in conformity to a positioning mark on a matrix substrate mounting surface 1a of a mounting substrate 1. Next, the matrix substrate mounting surface 1a of a mounting substrate 1 is brought into contact and fixed with positioning guide blocks 8 provided on the horizontal plane 9a and a vertical plane 9b of an assembly surface plate 9, and the bottom surface and the side surface of the mounting substrate 1 are brought into contact and fixed with the horizontal surface 9a and the vertical surface 9b of the assembling surface plate 9, respectively. All mounting substrates are likewise fixed on the respective designated position of the assembling surface plate 9, thereby automatically finishing the optical axis alignment of all modules.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山顧公開番号

特開平5-165015

(43)公開日 平成5年(1993)6月29日

(51) Int.Cl.5		識別記号	广内 整理番号	FI		技術表示箇所
G 0 2 F	1/1333	r	8806-2K		•	
	1/13	505	8806-2K			
	1/1347	٠	7348 – 2K			

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

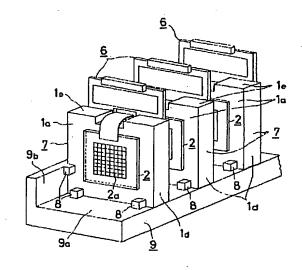
(21) 出願番号	特顯平3-328843	(71) 出願人 000004226
	•	日本電信電話株式会社
(22) 川嶼口	平成3年(1991)12月12日	東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
		(72)発明者 白井 誠一
		東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日
		本電信電話株式会社内
		(72) 発明者 入田 幸男
•		東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日
		本電信電話株式会社内
		(74)代理人 弁型士 菅 隆彦
	/	

(54)【発明の名称】 光モジュールの実装方法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】多数の光スイッチモジュールの光軸合わせを面倒な関係無しに簡単に実行できる2次元光スイッチモジュールの実装方法を提供する。

【構成】まず液晶光スイッチマトリックス基板2を実装基板1のマトリックス基板搭載而1a上の位置定めマークに合わせて固定する。つぎに組付定盤9の水平面9aと垂点而9b上に設けられた位置合わせガイドブロック8に実装基板1のマトリックス基板搭載而1aが当接し、また実装基板1の底面および側面が、それぞれ組付定盤9の水平而9aと垂直而9bに当接するように固定する。すべての実装基板をこれと同様にして組付定盤9のそれぞれの指定位置に固定すると自動的に全モジュールの光軸合わせが完了する。



【特許請求の範囲】

【間求項1】光素子基板と実装基板とからなる光モジュ ールを複数個用いて構成する光システムに於いて、ま ず、表面の光素子基板搭載面に直交しかつ相互に直角す る基準側面から所定間隔を隔てた位置決めマークを有す る前記実装基板上に、当該位置決めマークに重合対応す る位置合せマークを有する光楽子基板を、前配実装基板 上の位置決めマークと前記光素子基板の位置合せマーク が重合する様に位置決め載置した後、適宜手段により固 定して前記実装基板上に前記光素子基板を搭載して光モ 10 ジュールを形成し、次いで、当該形成した光モジュール を組付定盤に搭載実装する際には、当該組付定盤の互に 直交する内側直角面上に亙る同一平面上に設けられた複 数の位置合せガイドに、前配実装基板の光条子基板搭載 面を当接し、かつ前記実装基板の直角基準側面をそれぞ れ前記組付定盤の前記内側直角面に当接して直角度、平 行度を保持して、前記組付定盤上での前記光モジュール を位置決めした後、適宜手段にて固定して前配光モジュ ールを前配組付定盤に並行して搭載実装することを特徴 とする光モジュールの実装方法

【請求項2】実装基板上の位置決めマーク及び光索子基 板の有する位置合せマークの形状は、各々直交する二本 の細線で十字形に構成され、かつ前記光条子基板の有す る位置合せマークの各両端部位の幅方向に等間隔に空け た極細線を並行目盛ったことを特徴とする請求項1記載 の光モジュールの実装方法

【請求項3】 実装基板は、光素子基板周縁を搭載する面 位置にU字形構を掘設し、当該U字形構の両端部位は、 前記光素子基板の周縁を跨がって外側に食み出し掘削 し、当該U字形溝の食み出し両端のうち、片方から接着 30 剤を让人固化させ、前記実装基板及び光素子基板を固定 することを特徴とする請求項1又は2記載の光モジュー ルの実装方法

【湖求項4】組付定盤は、直交するその内側直角而上に 雇る同一平面上に設けられた複数の位置合せガイドに、 前配実装基板の光系子基板搭載而を当接し、かつ前配実 装基板の直角基準側面をそれぞれ前配組付定盤の直交す る内側直角面に当接して直角度、平行度を保持して、前 記組付定盤上での前記光モジュールを位置決めした後、 間定する際には、的記実装基板の直角基準側面を前記組 付定盤の内側直角面に引張力若しくは押付力によって固 定することを特徴とする請求項1、2又は3記載の光モ ジュールの実装方法

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本発明は、光通信網や光交換シス テムにおいて、光信号の光路変換に用いられる光スイッ チングシステム等の組立を高裕度かつ容易に行うための 光モジュールの実装方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光スイッチ、レンズ、偏光素子等 の光素子たる光学部品を用いて、光スイッチングシステ ムや光情報処型システムを構成する場合、個々の光部品 を組み合わせる際には、光軸合せを精密に行う必要があ るので、調整機構を設けて紅立を行うのが一般的であっ た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来の光スイッチングシステムや光情報処理システムの光 学部品の組合せに於いては、組立装置の小型化が難し く、亦、当該組立装置は調整機構を多く有するため振 動、温度変化等による調整ズレ等の問題が生ずるため信 頼性に問題があった。

【0004】更に、使用する光学部品の数が増加する と、調整する時間も多く必要となるため、量産化が難し く、コストを安く出来ない等の欠点があった。こゝに於 いて、本発明は、前記従来の課題に鑑み、多数の光モジ ユールの光軸合せを複雑な調整無しに、容易に行うこと の出来る光モジュールの実装方法を提供せんとするもの である。

[0005]

20

【課題を解決するための手段】前記課題の解決は、本発 明が次に列挙する新規な特徴的構成手法を採用すること により達成される。即ち、本発明法の第1の特徴は、光 **条子基板と実装基板とからなる光モジュールを複数個用** いて構成する光システムに於いて、まず、表面の光素子 基板搭載面に直交しかつ相互に直角する基準側面から所 定間隔を隔てた位置決めマークを有する実装基板上に、 当該位置決めマークに重合対応する位置合せマークを有 する光案子基板を、前配実装基板上の位置決めマークと 前記光索子基板の位置合せマークが重合する様に位置決 め戦慢した後、適宜手段により固定して前配実装基板上 に前記光紫子基板を搭載して光モジュールを形成し、次 いで、当該形成した光モジュールを組付定盤に搭載実装 する際には、当該組付定盤の互に直交する内側直角面上 に亙る同一平面上に設けられた複数の位置合せガイド に、前配実装基板の光菜子基板搭載面を当接し、かつ前 紀実装基板の直角基準側面をそれぞれ前記組付定盤の前 記内側直角面に当接して直角度、平行度を保持して、前 記組付定盤上での前記光モジュールを位置決めした後、 適宜手段にて固定して前配光モジュールを前配組付定盤 に搭載実装してなる光モジュールの実装方法である。

【0006】本発明法の第2の特徴は、前配第1の特徴 に於ける実装基板上の位置合せマーク及び光紫子基板の 有する位置合せマークの形状が、各々直交する二本の細 線で十字形に構成され、かつ前記光素子基板の有する位 置合せマークの各両端部位の幅方向に等間隔に空けた極 細線を並行目盛ってなる光モジュールの実装方法であ

50 【0007】本発明法の第3の特徴は、前記第1又は第 2

2 の特徴に於ける実装基板が、光素子基板周級を搭載する而位置にU字形溝を掴設し、当該U字形溝の両端部位は、前配光素子基板の周線を跨がって外側に食み山し期削し、当該U字形溝の食み出し両端のうち、片方から接着剤を注入固化させ、前記実装基板及び光素子基板を固定してなる光モジュールの実装方法である。

【0008】本発明法の第4の特徴は、前配第1,第2 又は第3の特徴に於ける組付定盤が、直交するその内側 値角面上に亙る同一平面上に設けられた複数の位置合せ ガイドに、前配実装基板の光素子基板搭載面を当接し、 かつ前記実装基板の直角基準側面をそれぞれ前記組付定 盤の直交する内側直角面に当接して直角度,平行度を保 持して、前記組付定盤上での前記光モジュールを位置決 めした後、固定する際には、前記実装基板の直角基準側 面を前記組付定盤の内側直角面に引張力若しくは押付力 によって固定してなる光モジュールの実装方法である。

[0009]

【作用】本発明は、前配のような手法を篩じたので、光素子基板と実装基板とからなる光モジュールを形成する際には、前記実装基板表面の光楽子基板搭載面の位置決 20 めマークと光索子基板の有する位置合せマークが重合する様、前記実装基板上に前記光業子基板を位置決め載置する。その後、接着剤等により前記実装基板及び光索子基板を固定して、前記実装基板への前記光案子基板搭載が完了する。

【0010】次に、前記形成した光モジュールを組付定盤に搭載実装する際には、組付定盤の内側直角面上に亙る同一平面上に設けられた複数の位置合せガイドに、前記光モジュールを構成する実装基板の光業子基板搭載面を当接すると共に、当該実装基板の直交する直角基準側面をそれぞれ前記組付定盤の内側直角面に当接して直角度、平行度を保持して位置決めを行う。その後、螺子止め若しくはパネによる押し付け等、適宜手段にて前記光モジュールを構成する実装基板の直角基準側面及び組付定盤の内側直角面を固定して、前記組付定盤への前記光モジュールの搭載実装が完了する。

[0011]

【実施例】本発明の実施例を図面につき詳説する。尚、本実施例では、光モジュールとしての二次元光スイッチモジュールが、光素子基板としての被晶光スイッチマトリックス基板と実装基板から構成される被晶光スイッチモジュールを用いた場合を説明する。

【0012】図」は実装基板上に液晶光スイッチマトリックス基板を搭載する組立要領図、図2(a)は位置決めマーク及び位置合せマークの形状の一例を示す説明図、同図(b)は図2(a)中、位置決めマーク位置と位置合せマークの重合端部拡大図である。図中、1は中央に窓孔αを質散した実装基板、2は液晶光スイッチマトリックス基板、3は位置決めマーク、1は位置合せマークである。

【0013】先ず、実装基板1上に光スイッチマトリックス基板2を搭載する本実施例法の手順に附いて詳説する。実装基板1は左右前後両側面が各々平行である矩形の平面基板であり、当該実装基板1のマトリックス基板搭載面1aの窓孔α開角部周辺上には、当該実装基板1の側面の内、相互に直角関係にある基準側面1b,1cから所定間隔を於いて、図2に示す位置決めマーク3が印してある。尚、前記基準側面1b,1cは、前記マトリックス基板搭載面1aとは、各々直角関係になるようの成形されている。

【0014】一方、搭載すべき被晶光スイッチマトリックス基板2は、液晶光スイッチマトリックスセル2aを透明基板2b上に形成したものであり、当該被晶光スイッチマトリックス基板2の透明基板2bの隅角部上には、フォトリソグラフィにより図2に示す位置合せマーク4が、前記実装基板1のマトリックス基板搭載面1a上に印された位置決めマーク3と同数でかつ同一位置関係に形成されている。亦、当該各々の位置合せマーク4は、前記液晶光スイッチマトリックスセル2a外枠と一定の位置関係を持つように形成されている。

【0015】前記実装基板1のマトリックス基板搭載面1a上に印された位置決めマーク3と前記液晶光スイッチマトリックス基板2の透明基板2b上に形成された位置合せマーク4とが図2の様に重合する位置に、前記実装基板1上に液晶スイッチマトリックス基板2を載置することで、前記液晶光スイッチマトリックス基板2を載置することで、前記液晶光スイッチマトリックス上ル2a位置は、前記に変装基板1の基準となる基準側前1b,1cより一定の間隔を正確に保持することが出来る。前記の如く液晶光スイッチマトリックス基板2は透明基板材料で構成されているので、前記実装基板1のマトリックス基板搭載面1a上に印された位置決めマーク3と前記液品光スイッチマトリックス基板2の透明基板2b上に形成された位置合せマーク4との重合作業は容易に行うことが出来る。

【0016】前記図2(a),(b)に示す位置決めマーク3及び位置合せマーク4の形状を詳説する。前記位置決めマーク3及び位置合せマーク4は、直交する二本の細線よりなる十字形状となっている。更に、前記液晶光スイッチマトリックス基板2上の位置合せマーク4は、前記実装基板1と当該被晶スイッチマトリックス基板2との位置合せを高精度に出来るよう、先端部分幅方向に互り細かく等間隔に分割した極細線1aを並行目盛っている。

[0017] これにより、前記実装基板1上の位置決めマーク3と前記被品スイッチマトリックス基板2上の位置合せマーク4との位置ズレを容易に検出することが出来るため、合せ特度を向上する事が出来ると共に、位置合わせを短時間で行うことが可能となる。さらに前記位置合せマーク4の先端部分の極細線4aの間隔や線隔を変化することで会せ特定を一個向とすることが出来る。

50 変化することで合せ精度を一屆向上することが出来る。

30

5

【0018】尚、前配位置決めマーク3は前記実塾基板1が金属材料の場合には、ケガキ加工による方法、或いは、レーザビーム加工による方法等により形成することが出来る。亦、前記実装基板1の材料とじては、金属材料の他にセラミック材料を用いることも出来、この場合には、前記金属材料の場合と同様にレーザビーム加工により位置決めマーク3を形成する。

【0019】次に、前配実装基板1と液晶光スイッチマトリックス基板2との固定方法を説明する。図3は、当該固定方法を説明する平面図である。実装基板1上の液 10 晶光スイッチマトリックス基板2 周縁を搭載する側に、U字形の溝5を抽設しておく。

【0020】当該U字形薄5は、両端部位を除く湾曲部を前記液晶光スイッチマトリックス基板2と重合する様、内側に配置され、両端部位は前記液晶光スイッチマトリックス基板2とは重合しない外側に臨んで食み出し配置されている。前記U字形薄5の片側から接着剤を注入し、固化させることにより前記実装基板1と液晶光スイッチマトリックス基板2とを固着することが出来る。

【0021】この際、前記の如くU字形溝5の両端は前 20 記被品光スイッチマトリックス基板2の外側に食み出す様に配置してあるので、当該被晶光スイッチマトリックス基板2が前記実装基板1に接する箇所に気泡等を生じることなく接着剤を注入出来、前記実装基板1と被晶光スイッチマトリックス基板2との間に隙間を生じることなく両者を固着することが出来ると共に、前記液晶光スイッチマトリックス基板2は実装基板1に対して、特度良く平行の位置に配置、固定することが出来る。前記U字形溝5の形状は、U字形の他、両端が液晶光スイッチマトリックス基板2の外側に臨むよう配置されていれば 30 良く、両端間の形状は直線状に折れ曲がっていても効果は同様に得られることは言うまでもない。

【0022】次に、前配組み立てた実装基板1及び液晶光スイッチマトリックス2を組付定盤上に実装する方法を説明する。図1は、実装基板1に液晶光スイッチマトリックス基板2及び被晶マトリックスセル2aを駆動する回路基板6を搭載した液晶光スイッチモジュール7を位置合せガイドブロック8群の位置決めにより互いに平行の位置関係となる様、組付定盤9の水平面9a上に実装した状態の説明図である。

【0023】前記横倒しし形和付定盤9は互いに直交する水平面9aと垂直面9bよりなる内側直角面を有しており、当該水平面9a及び垂直面9bには、被晶光スイッチモジュール7を前配水平面9aに対して垂直立設する為の位置合せガイドブロック8が同一平面上に複数個数けられている。前配実装基板1のマトリックス基板搭載面1aを、基準側面1b,1cがそれぞれ前記組付定盤9の垂直面9b,水平面9aに当接するよう、前配同一平面上の位置合せガイドブロック8群に押し付け固定することで、当該実装基板1は、前記組付定盤9の水平

面9a及び垂直面9bに対して、液晶光スイッチマトリックス基板2を搭載する前記マトリックス基板搭載面1aが垂直になり、当然前記液晶光スイッチマトリックスセル2aも同様に垂直となる。

【0024】同様の方法で、複数の液晶光スイッチモジュール7を組付することにより、各液晶光スイッチモジュール7の実装基板1は互いに平行な位置関係を保持することが出来ると同時に、前記各実装基板1に搭載された液晶光スイッチマトリックス基板2の各々の液晶光スイッチマトリックスセル2aは、前に実装基板1の基準となる基準側面1b,1cから同一間隔を隔てるよう配置するものであるから、前配各液晶光スイッチマトリックスセル2aは同一光軸上に存在することとなる。

【0025】前記のような実装方法をとることで、被品 光スイッチマトリックス基板2上の液晶光スイッチマト リックスセル2aの位置を互いに同一光軸上に配置する ことが極めて容易に実現出来る。前記組付定盤9の材料 としては、金属材料の他にセラミック材料を用いても同 様の効果が得られることは言うまでもない。

【0026】更に、実装基板1と組付定盤9の固定法に 附いては、実装基板1の基準側面1b,1cに各々図示 しない固定用螺子穴を質設し、かつ当該螺子穴に対応す る螺子穴(図示せず)を前配組付定盤9に貫設して、前 記実装基板1の基準側面1b,1cと前配組付定盤9の 垂直面9b,水平面9aとをそれぞれ螺子で引っ張ることにより、直角度及び平行度を保ちながら固定する。これにて前記実装基板1のマトリックス基板搭載面1aの 組付定盤9の水平面9a,垂直面9bに対する直角配置が確保される。

【0027】他の固定法としては、パネ材を用いて、位置合せガイドブロック8群と当接している实装基板1のマトリックス基板搭載面1aとは反対の面を前配位置合せガイドブロック8群に押し付け固定し、更に、組付定盤9の水平面9aと当該水平面9aと当接している前記を整りの垂直面9bと当該水平面9bと当接している前記実装基板1の基準側面1bとは反対側の側面1dを前記同様にパネによって押し付けることで、螺子による固定と同様直角度及び平行度を保ち、前記実装基板1のマトリックス基板搭載面1aの組付定盤9の水平面9a,垂直面9bに対する直角配置を確保することが出来る。

【0028】以上の本実施例は、二次元光スイッチモジュールとして、液晶光スイッチモジュールを用いた場合について述べたが、液晶以外の、例えば薄膜マイクロミラーを用いて二次元光スイッチマトリックスを構成した場合、或いはPL2Tを用いた二次元光マトリックスの

50

40

(5)

場合、他の光案子を用いたその他の光モジュールの場合 にも広く、同様の実装方法が有効であることは前記本実 施例から明らかである。

[0029]

【発明の効果】かくして、本発明によれば、光スイッチングシステムや光情報処理システムの組立、実装を精度良く、かつ容易に行えるだけでなく、組立信頼性が高く、しかも組立時間を大幅に短縮出来るため、製造にかかるコストを軽減出来る等、様々な実用性、有用性を具有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例において、実装基板上に液晶光スイッチマトリックス基板を搭載する際の組立要領図である。

【図2】同上において、(a)は位置決めマークおよび 位置合せマークの形状の一例を示す説明図、(b)は位 置決めマークと位置合せマークの重合端部拡大図であ る。

【図3】同上における実装基板と液晶光スイッチマトリックス基板との固定方法を説明する平面図である。

【図4】 同上における液晶光スイッチモジュールを組付

定盤の水平面上に実装した状態の説明斜視図である。 【符号の説明】

1…実装基板

1 a…マトリックス基板搭載面

1b, 1c…基準側面

1d, 1e…側面

2…液晶光スイッチマトリックス基板

2 a…液晶光スイッチマトリックスセル

2 b…透叨基板

10 3…位置決めマーク

4…位置合せマーク

4 a…極細線

5…U学形帶

6…回路基板

7…液晶光スイッチモジュール

8…位置合せガイドブロック

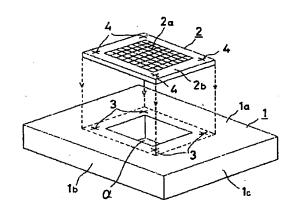
9 …組付定盤

9 a …水平面

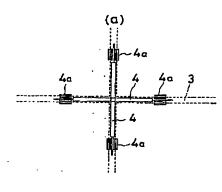
9 b ···垂直面

20 α…窓孔

[図1]







(b) 4 4a 3 4a

(6)

特開平5-165015

